

江苏先锋精密科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：先锋精科

证券代码：688605

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称	2026年1月6日：平安证券、证券时报 2026年1月15日：兴全基金、汇添富基金、西部利得基金、长信基金、中银基金、中信保诚基金 2026年1月20日：博衍基金、银叶投资、泾溪投资、中信建投证券、第一创业证券、恒越基金、东亚前海证券、国泰基金、合远基金 2026年1月21日：浙商证券、中国人寿养老保险 2026年1月22日：华泰证券、银华基金 2026年1月23日：泰康资产 2026年1月26日：兴业证券、西部利得基金 2026年1月28日：华夏基金、英领私募基金、天风证券、浙商证券
时间	2026年1月6日、15日、20日、21日、22日、23日、26日、28日
地点/方式	公司会议室、线上会议方式调研、上海
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：XU ZIMING；董事、董事会秘书：XIE MEI；证券事务代表：王兆俊
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍基本情况 公司是国内半导体设备关键精密零部件的供应商，于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市。上市以来公司坚持高质量发展战略，进行了产能布局、团队整合、新品研发及业务版图开拓等工作。 在产能布局方面，在原有先锋制造一厂及表处中

心的基础上，2025年公司第二表处中心（靖江先捷）新建产线项目及部分技改升级项目已投产；新建的先锋制造二厂已完成竣工验收。如果投入设备、员工等后达到满产，公司在靖江的产能预期可增加至18-20亿元。无锡先研募投项目依照计划已于2025年第一季度启动建设；若满产，能为公司增加5-10亿元的产能。

在团队整合方面，公司于2025年1月将无锡至辰收购为公司全资子公司，该公司创始人刘国辉博士多年来主要从事粉末冶金、热等静压致密化及扩散链接等方面的研发和产业化工作，具有丰富的技术开发和公司管理经验。在加入公司后，刘国辉已被公司任命为首席技术官、研发中心总经理，主导研发工作，进一步加强了公司研发团队实力。

在新产品开发方面，公司在加热器等半导体先进功能器件的研发上持续加大研发力度，目前新产品正在客户端进行验证，进度按计划进行，如验证顺利今年将实现收入。

在业务版图开拓方面，基于在半导体领域积累的丰富精密制造经验，公司将积极拓展高端医疗设备、航空、商业航天方面的布局。医疗设备方面公司向医科达等客户供应头框架、诊疗仪、放疗设备等高端医疗设备器件和零部件；航空业务已通过航空结构件表面处理的航空质量管理体系标准认证AS9100D，目前正在准备其它航空制造所需认证，如NADCAP认证、产品认证等，未来的主要客户是上海商飞及其供应商；商业航天方面已开始部分产品的表面处理业务，主要面向客户为民用火箭制造企业，目前已实现部分收入但金额相对较低。

二、投资者主要问题回答

1、子公司无锡先研的业务构成及产能情况？

答：无锡先研目前拥有9,000m²的租赁厂房，产品主要包括部分半导体精密零部件、模组及医疗设备零部件产品。募投项目新建厂房已封顶。

2、公司提到在靖江的产能预期可增加至18-20亿元，上述产能是否包括加热器新产品？

答：加热器新产品产能未包含在上述产能内。

3、公司未来是否有在北方设厂的计划？

答：为及时响应北方客户的产品和维保需求，公司计划在北京设立备货仓库，目前没有在北方设厂计划。

4、半导体上游扩产计划对公司的影响如何？

答：公司与芯片厂扩产间接关联，作为半导体设备零部件的供应厂商，公司订单与设备需求直接相关，如果上游设备需求释放预计将较快体现在公司订单上。

5、目前市场需求情况、公司订单情况如何？

答：从公司了解的市场反映看，芯片厂扩产需求比较乐观。公司已为半导体扩产预备了充足产能，目前在手订单充足，产能利用率维持较高水平。

6、公司产品对客户的价格情况如何？

答：公司产品对客户的报价水平相对比较稳定，具体产品需根据加工难度、时间等与客户进行具体协商。

7、近期金属大宗商品价格对公司的影响如何？

答：公司金属零部件产品的主要原材料为铝，目前铝价上涨将会造成公司成本一定程度的增加，若铝价后续价格波动较大，公司会与客户协商调整产品价格。

8、公司未来是否有向上下游产业链并购扩张的计划？

答：公司坚持以半导体精密零部件为主业，积极开发高端医疗设备、航空、商业航天等领域业务，目前公司暂无并购同行业公司计划，未来不排除在合适时间、选择合适标的，通过并购方式增加市场覆盖面。

9、公司未来是否会实施股权激励计划？

答：公司始终重视股权激励对核心团队的绑定与激励作用，在保证业绩平稳发展的同时，公司会在适当的时间通过股权激励等方式，实现核心团队与公司及股东利益的深度绑定，从而保障核心团队的稳定与壮大。